上海市2021年度“科技创新行动计划” 集成电路科技支撑专项

拟立项项目清单

（排名不分先后）

| **序号** | **项目名称** | **承担单位** | **负责人** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型二维半导体在3纳米以下集成电路中的应用 | 复旦大学 | 包文中 |
| 2 | 基于高导热衬底的氧化镓异质集成器件关键技术研究 | 复旦大学 | 马宏平 |
| 3 | 基于金属氧化物薄膜晶体管的3D-DRAM存储技术研究 | 复旦大学 | 朱颢 |
| 4 | 铌酸锂光子芯片的高效率、高精度制造技术与方法研究 | 华东师范大学 | 程亚 |
| 5 | 基于国产材料的300mm大硅片化学机械抛光工艺研究 | 上海集成电路材料研究院有限公司 | 黄嘉晔 |
| 6 | 高速高精度模数转换芯片研发及应用 | 上海芯炽集成电路技术有限公司 | 吴旭凡 |
| 7 | 面向5G高性能滤波器的POI晶圆工程化技术研究 | 上海新硅聚合半导体有限公司 | 黄凯 |
| 8 | 面向化合物半导体量产线高功率射频器件PDK模型建模平台与高灵敏度太赫兹量子器件建模技术 | 上海新微半导体有限公司 | ZHOU ZEYANG |
| 9 | 大规模超导集成电路高保真器件模型研究 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 应利良 |